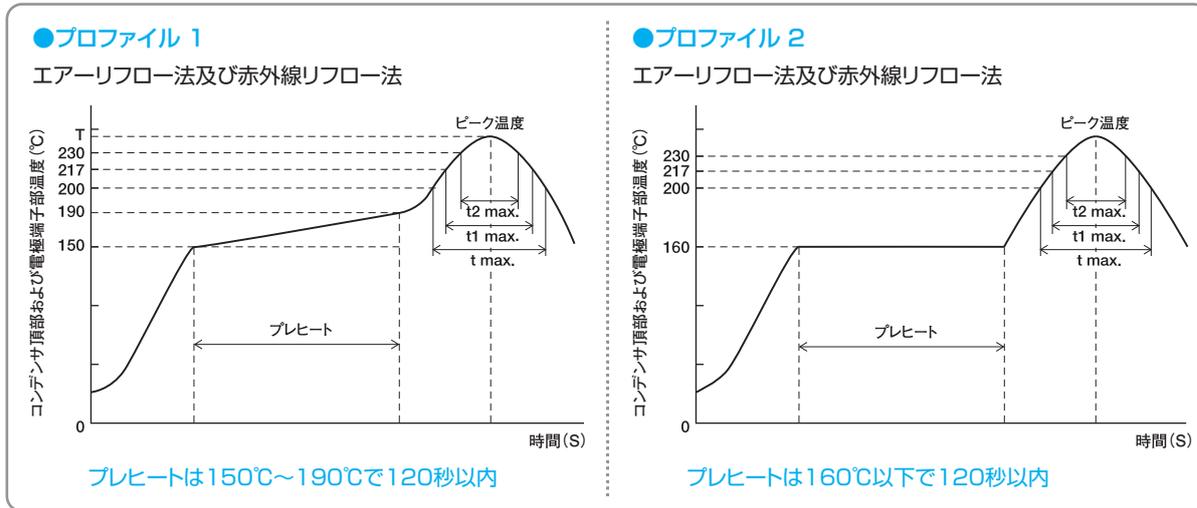


はんだ付け条件・リフロー許容条件・リップル電流周波数補正係数

■はんだ付け条件

- 手はんだの場合、特に規定の無い限り、350℃、3秒以下にて使用してください。
- フローはんだの場合、特に規定の無い限り、260℃、10秒以下にて使用してください。(面実装形には適用しないでください。)
- 熱硬化炉等を通す場合は、150℃以下の雰囲気中で2分以内としてください。

■面実装形リフロー許容条件



シリーズ名	電圧範囲 (V)	対象サイズ	200℃以上での滞留時間(t)	217℃以上での滞留時間(t1)	230℃以上での滞留時間(t2)	ピーク温度(T)	回数	プロファイル
HVHZ-HVH HVPZ-HVP HVT, HVJ	16~63	全サイズ	100秒以内	80秒以内	40秒以内	260℃(5秒以内)	2	1
	80~125	全サイズ	100秒以内	80秒以内	40秒以内	250℃(5秒以内)	2	1
FVL, HVHF HVPF, HVPX HVTX, HVHY HVPY, HVTY, HVHC HVPC, HVPC FVC, FVFP FVF, FVS	6.3~63	全サイズ	70秒以内	50秒以内	40秒以内	260℃以下	2	2
	80~100	全サイズ	70秒以内	50秒以内	40秒以内	260℃以下	1	2
			70秒以内	50秒以内	40秒以内	250℃以下	2	2

上記の条件で2回目のリフローを行う場合は、1時間以上自然放冷し、基板および部品が常温に復帰後行ってください。

■リップル電流周波数補正係数

シリーズ名	定格静電容量 C(μF)	周波数:f(Hz)								
		100≤f<1k	1k≤f<5k	5k≤f<10k	10k≤f<20k	20k≤f<30k	30k≤f<40k	40k≤f<50k	50k≤f<100k	100k
FVL, HVHZ-HVH HVPZ-HVP, HVT HVJ, HVHF, HVPF HVPX, HVTX, HVHY HVPY, HVTY, HVHC HVPC, HEH HEHZ, HEPZ, HEHF HEPF, HEPC	C≤22	0.05	0.25	0.45	0.55	0.65	0.70	0.75	0.80	1.00
	22<C≤47	0.10	0.35	0.55	0.65	0.75	0.80	0.80	0.85	1.00
	47<C≤150	0.10	0.40	0.65	0.70	0.80	0.85	0.85	0.90	1.00
	150<C	0.15	0.45	0.65	0.75	0.80	0.85	0.85	0.90	1.00
FVS	全機種	0.10	0.20	0.40	0.50	0.65	0.75	0.80	0.85	1.00

シリーズ名	ケースサイズ φD	周波数:f(Hz)								
		100≤f<1k	1k≤f<5k	5k≤f<10k	10k≤f<20k	20k≤f<30k	30k≤f<40k	40k≤f<50k	50k≤f<100k	100k
FVC, FVFP, FVF, FEC, FEFP, FEF	φ5, φ6.3	0.15	0.35	0.55	0.60	0.75	0.80	0.85	0.90	1.00
	φ8	0.15	0.40	0.65	0.70	0.80	0.85	0.90	0.90	1.00
	φ10	0.20	0.50	0.65	0.75	0.85	0.90	0.90	0.95	1.00

リップル電流を重畳したときのピーク電圧が、定格電圧を超えないようにしてください。
リップル電流を重畳したときのピーク電圧が、逆電圧にならないようにしてください。